



スケジュール一例

-	-	【1日目～】 仙台市内で会議や研修
9:00	10:30	【最終日】仙台中心部から車で約50km
10:30	11:30	施設見学（約50分）
12:00	13:00	天童市内にて昼食
13:00	15:00	周辺施設を見学
15:00	-	帰路へ

4つの事業が織りなす進化

■ 半導体事業

高セキュリティ工場で、半導体・各種センサパッケージを製造。ウエーハBGからテストング、梱包までのアセンブリを行っております。

■ 樹脂成型事業

プラパックス®でご要求仕様・機能に適合した中空パッケージを実現。自社設計により、お客様のニーズに柔軟に対応する事が出来ます。

■ 装置事業

社内に生産ラインを有するメリットを十分に発揮、生産ラインで培った高い技術力でお客様ニーズに応えます。

■ 自動車部品事業

自動車産業の変化を先取りする高い技術力と信頼性。自社開発の各種合理化装置を活用し、高品質で低コストの製品を提供します。

対象期間

通年（土日祝を除く）
※繁忙期等、日によって承れない場合あり

適応条件

- ・料金：無料
- ・適用人数：要相談
- ・所要時間：約60分

備考

日本語対応のみ/施設内写真撮影禁止/飲食禁止

予約・ 問い合わせ先

仙台観光国際協会がお取次ぎいたします。
MICE事業部 TEL：022-268-9603 または
conv@sentia-sendai.jp